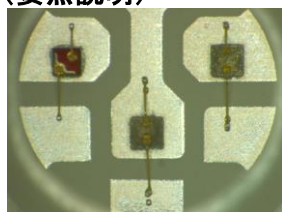


ひとわざ(一技)名: LEDベアチップなどの受発光素子、センサーチップの実装

1. 概要(200字目安)

- 1個からでも対応できる半導体ベアチップ実装メーカーです。
 ・試作から少量量産までのワンストップサービスを提供しております。
 ・実装技術については、COB(ワイヤーボンディング実装)及びLCDモジュール(ACF実装)の量産経験をベースとしております。
- ワイヤーボンディングの工法を幅広くカバー
 - ・金ワイヤー(ボールボンド/ウェッジボンド/リボン)
 - ・アルミワイヤー(ウェッジボンド細線・太線/リボン)
 - フリップチップボンディング
 - ・ACF(異方性導電フィルム)を用いた加熱加圧方式に対応
 - シーム溶接機を保有し、MEMSなど気密封止が必要な試作・量産にも対応

写真・図(要点説明)



LEDベアチップの実装



ICのACF実装(COF)



アルミワイヤーボンディング

金ワイヤーボンディング

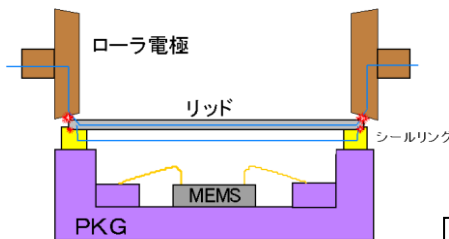
- ・L/S=60μm/20μm

ACF実装

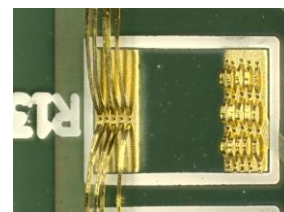
- ・COG L/S=35μm/15μm
- ・COF L/S=33μm/17μm
- ・FOB L/S=55μm/55μm

気密封止(シーム溶接)

- 対応パッケージサイズ: 2.0mm~60mm
- 封止圧力: 大気圧~高真空(5x10⁻³pa以下)
- 封止ガス: N₂(他ガスは要相談)



気密封止(シーム溶接)



金リボンボンディング
(W=100μm)

2. 企業概況

フリガナ	カブシキガイシャ イングスシナノ	フリガナ	コバヤシ ヒデトシ
会社名	株式会社イングスシナノ	代表者名	小林 秀年
		フリガナ	エイギョウグループ
事業内容	電子デバイス、モジュールの製造	窓口担当	営業グループ
主要製品	携帯機器向け液晶パネルモジュール・各種半導体ベアチップ実装		
フリガナ	ナガノケンスワゲンシモスワマチキタシオウ		
住所	〒393-0042 長野県諏訪郡下諏訪町北四王5415		
電話/FAX	0266-27-8056 / 0266-28-0325(窓口担当)	E-mail	ings-shinano@ings-s.co.jp
資本金(百万円)	20	設立年月	1946年
		売上(百万円)	1,300
		従業員数	70

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ① ISO9001/ISO14001/TS16949(LetterOfCompliance)/医療機器製造業登録/ソニーグリーンパートナー認定
- ② 生体センサー及び生体センサー応用製品開発時の微細実装技術
 - ・光学素子(発光素子、受光素子)及び光学素子応用製品開発時の微細実装技術
 - ・MEMS(マイクロエレクトロメカニクスシステム)及びMEMS応用製品開発時の微細実装技術
- ③ 医療機器開発品実装試作、医療検査機器用基板実装、腕時計型ヘルスケア機器の脈拍センサー部実装量産

※機械設備、最新情報につきましては、下記URLでご確認下さい。

<http://www.ings-s.co.jp/facility/>